



德州仪器发函涨价，玻璃基板有望成为发展趋势

半导体行业周报

投资评级：推荐（维持）

报告日期：2026年03月16日

- 分析师：何鹏程
- SAC编号：S1050525070002

研究创造价值

德州仪器发函涨价，模拟芯片行业触底回暖

根据集微网报道，德州仪器近日已向下游发函，宣布自4月1日起对部分零部件涨价15%-85%，覆盖所有订单和发货。作为全球模拟芯片龙头，此轮涨价标志着此前持续两年的价格战与库存去化阶段基本结束，下游工业、汽车电子需求回暖推动行业进入盈利修复通道。对国内模拟厂商而言，TI涨价带来双重利好。一方面，价格跟随效应下，国产厂商有望跟进调价，毛利率有望逐季修复；另一方面，TI涨价提升了国产芯片的性价比优势，工规及车规产品的替代窗口进一步打开，中低端市场有望为国产厂商让渡份额空间。

玻璃基板未来有望替代有机基板，连接密度提升

面对AI算力激增带来的散热与封装挑战，传统有机基板已逼近物理极限高温下的翘曲变形制约着芯片性能提升。玻璃基板凭借其出色的热稳定性、超光滑表面，比有机材料光滑5000倍以及可引导光信号的特性，成为突破瓶颈的关键：它不仅能将连接密度提升10倍、降低能耗，还能为芯片间光互联奠定基础，使同等面积内封装更多硅芯片成为可能。

建议关注：圣邦股份、思瑞浦、沃格光电、蓝特光学。

中美“关税战”加剧风险

中美科技竞争加剧风险

产先进制程进度不及预期风险

AI模型大厂资本开支不及预期风险

重点关注公司及盈利预测

公司代码	名称	2026-03-13 股价	EPS			PE			投资评级
			2024	2025E	2026E	2024	2025E	2026E	
300661.SZ	圣邦股份	72.73	1.06	0.96	1.3	68.49	75.93	55.76	买入
603773.SH	沃格光电	41.02	-0.56	-0.49	0.63	-73.83	-83.90	65.10	买入
688127.SH	蓝特光学	58.53	0.55	0.96	1.19	106.42	60.97	49.21	未评级
688536.SH	思瑞浦	177.50	-1.47	0.95	2.71	-120.75	186.84	65.5	买入

资料来源：Wind，华鑫证券研究（注：“未评级”盈利预测取自万得一致预期）

目录

CONTENTS

1. 半导体板块周度行情分析
2. 行业高频数据
3. 行业动态
4. 公司公告

01 半导体板块周度行情分析

研究创造价值

1.1、周涨幅排行

3月9日-3月13日当周，海外龙头总体呈上涨态势。其中，美光科技领涨，涨幅为15.08%。

图表2：海外半导体龙头估值水平及周涨幅（%）

	证券代码	证券简称	国家/地区	市值(亿元)	PE(LYR)	PB(MRQ)	周涨跌幅(%)
处理器	INTC.0	英特尔(INTEL)	美国	2286.21	-856.26	2.00	5.41
	QCOM.0	高通(QUALCOMM)	美国	1385.18	25.00	6.00	-4.33
	AMD.0	超威半导体(AMD)	美国	3153.05	72.73	5.00	0.50
	NVDA.0	英伟达(NVIDIA)	美国	43800.75	36.48	27.85	1.37
存储	MU.0	美光科技(MICRON TECHNOLOGY)	美国	4796.13	56.17	8.16	15.08
模拟	TXN.0	德州仪器(TEXAS INSTRUMENTS)	美国	1736.98	34.93	10.67	-1.27
	ADI.0	亚德诺(ANALOG)	美国	1494.25	65.90	4.42	-3.08
	AVGO.0	博通(BROADCOM)	美国	15253.21	65.96	19.10	-2.52
	NXPI.0	恩智浦半导体(NXP SEMICONDUCTORS)	荷兰	482.29	23.86	4.80	-5.39
射频	SWKS.0	思佳讯(SKYWORKS)	美国	82.31	17.25	1.43	-0.13
	QRVO.0	QORVO	美国	72.38	130.15	1.96	0.62
功率半导体	STM.N	意法半导体	荷兰	292.14	175.99	1.64	4.82
	ON.0	安森美半导体(ON SEMICONDUCTOR)	美国	230.70	190.66	3.01	2.95
	IFX.DF	英飞凌科技	德国	517.52	50.99	2.97	1.05
光学	3008.TW	大立光	中国台湾	3129.83	14.71	1.66	-1.47
半导体设备	AMAT.0	应用材料(APPLIED MATERIAL)	美国	2710.42	38.73	12.48	5.17
	LRCX.0	拉姆研究(LAM RESEARCH)	美国	2649.89	49.45	26.12	6.46
	KLAC.0	科天半导体(KLA)	美国	1859.51	45.78	34.02	5.51
	ASML.0	阿斯麦	荷兰	5299.74	47.07	23.06	4.09
硅片	6488.TWO	环球晶圆	中国台湾	2067.84	28.28	2.22	-7.39
晶圆代工	2330.TW	台积电	中国台湾	561092.97	28.15	8.92	-1.32
	GFS.0	格芯(GLOBALFOUNDRIES)	开曼群岛	229.84	25.97	1.93	-10.71
化合物半导体	3105.TWO	稳懋	中国台湾	1326.93	78.34	3.19	4.86
封装	ASX.N	日月光投资	中国台湾	474.77	36.79	4.31	1.80
分销	ARW.N	艾睿电子(ARROW ELECTRONICS)	美国	71.75	12.56	1.09	1.50
	AVT.0	安富利(AVNET)	美国	48.90	20.36	0.99	-0.53

资料来源：wind，华鑫证券研究

1.2、申万一级行业估值水平

3月9日-3月13日当周，申万半导体指数整体呈现震荡下行的态势。3月13日，申万半导体指数为7,441.90，周跌幅为-2.60%。

图表3：近5年申万半导体指数

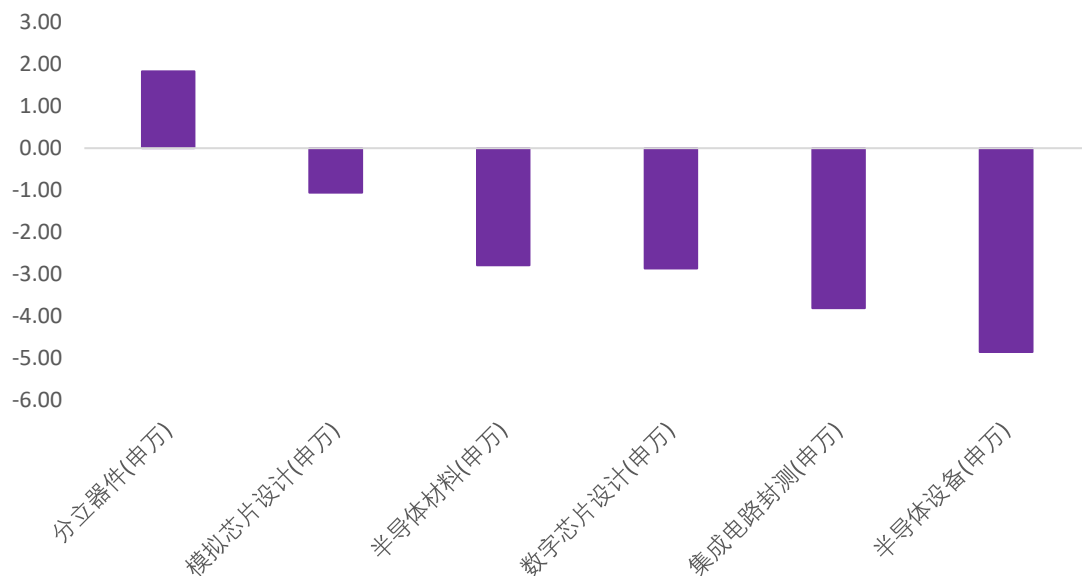


资料来源：wind，华鑫证券研究 注：按申万行业二级分类

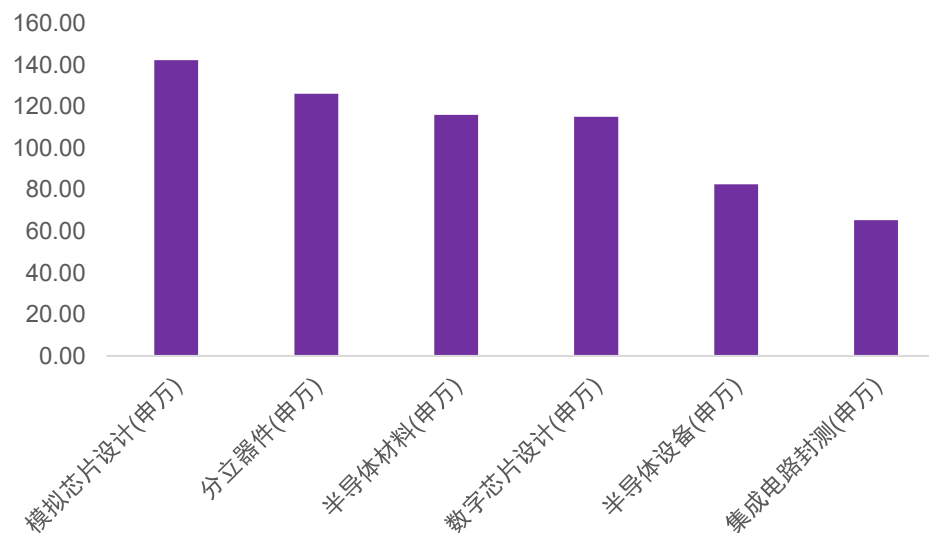
1.3、半导体细分板块周度行情梳理

半导体细分板块比较，3月9日-3月13日当周，半导体细分板块呈下跌态势。其中，半导体设备板块跌幅最大，达到-4.86%；分立器件板块上涨，达到1.84%。估值方面，模拟芯片设计，分立器件，半导体材料板块估值水平位列前三。

图表4：3月9日-3月13日半导体主要指数周涨跌幅比较（%）



图表5：3月13日半导体主要指数市盈率（TTM）比较



资料来源：wind，华鑫证券研究

1.4、申万二级行业板块资金流向

上周申万行业资金流向情况：

计算机设备块主力净流入3.76亿元，主力净流入率为0.23%，在9个二级子行业中排第1名；军工电子板块主力净流出72.2亿元，主力净流入率为-3.38%，在9个子行业中排第9名。

图表6：3月9日-3月13日申万行业资金流向情况

行业	主力流入额(万元)	主力流出额(万元)	主力净流入额(万元)	主力净流入率(%)	连续流入天数
SW计算机设备	5,260,490.64	5,222,928.67	37,561.97	0.23	-1
SW半导体	30,586,792.73	31,069,445.37	-482,652.65	-0.62	1
SW其他电子II	2,982,053.00	3,068,916.43	-86,863.43	-1.09	1
SW电子化学品II	3,362,618.94	3,486,447.38	-123,828.43	-1.25	1
SW通信设备	28,835,636.16	29,929,347.14	-1,093,710.98	-1.64	-3
SW消费电子	10,325,555.80	10,828,219.47	-502,663.67	-1.75	-3
SW航天装备II	1,843,789.40	2,002,398.62	-158,609.21	-2.35	-3
SW其他电源设备II	5,894,901.19	6,306,677.31	-411,776.12	-2.53	-3
SW军工电子II	7,487,221.88	8,209,476.64	-722,254.77	-3.38	-3

资料来源：wind，华鑫证券研究

1.5、半导体板块公司周涨幅前十股票

3月9日-3月13日当周，半导体板块公司周涨幅前十个股：德明利科微，国民技术，赛微微电，圣邦股份，长光华芯，银河微电，炬光科技，锆威特，斯达半导，周涨幅分别为18.05%，14.69%，13.77%，11.18%，10.62%，9.87%，9.12%，7.61%，7.37%，6.90%。

图表7：半导体板块公司周涨幅前十股票

证券代码	证券简称	市值 (亿元)	EPS			PE			PB	周涨跌幅 (%)
			2024	2025E	2026E	2024	2025E	2026E		
001309.SZ	德明利	726.02	2.36	3.15	4.57	207.01	142.36	98.24	22.21	18.05
300672.SZ	国科微	349.08	0.45	0.58	1.00	363.08	-	-	8.58	14.69
300077.SZ	国民技术	135.40	-0.40	-	-	-52.95	-	-	14.08	13.77
688325.SH	赛微微电	105.25	0.93	-	-	133.50	-	-	5.99	11.18
300661.SZ	圣邦股份	449.51	1.06	1.57	2.04	91.52	60.66	46.73	9.16	10.62
688048.SH	长光华芯	305.05	-0.57	-	0.44	-310.57	-	393.33	10.15	9.87
688689.SH	银河微电	47.81	0.56	-	-	69.96	-	-	3.96	9.12
688167.SH	炬光科技	296.09	-1.94	0.19	0.62	-169.28	1741.69	528.73	13.30	7.61
688693.SH	锆威特	33.71	-1.32	-	-	-34.68	-	-	4.25	7.37
603290.SH	斯达半导	256.00	2.12	2.22	3.24	49.86	48.11	33.01	3.70	6.90

资料来源：wind，华鑫证券研究

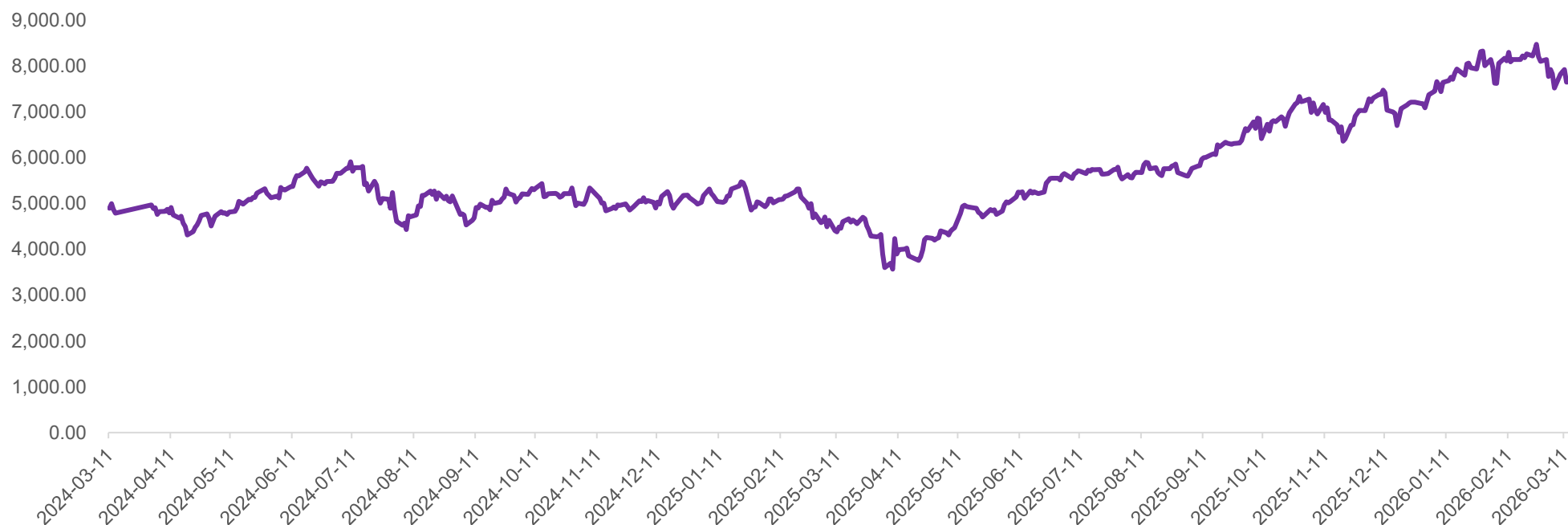
02 行业高频数据

研究创造价值

2.1、半导体：费城半导体指数

海外方面，3月9日-3月13日当周，费城半导体指数总体呈现震荡的态势，在2026年3月11日出现大幅上涨后又下跌，近两周整体呈现震荡的态势。更长时间维度上来看，2023年年底开始持续上涨。2024年上半年整体处于上升态势，7月出现大幅回调，8月处于震荡下行行情，9月出现探底回升，四季度总体处于震荡的态势。2025年一季度呈现先涨后跌的走势，4月后逐渐回升，二季度三季度均呈现震荡上行的态势。

图表8：费城半导体指数近两年走势

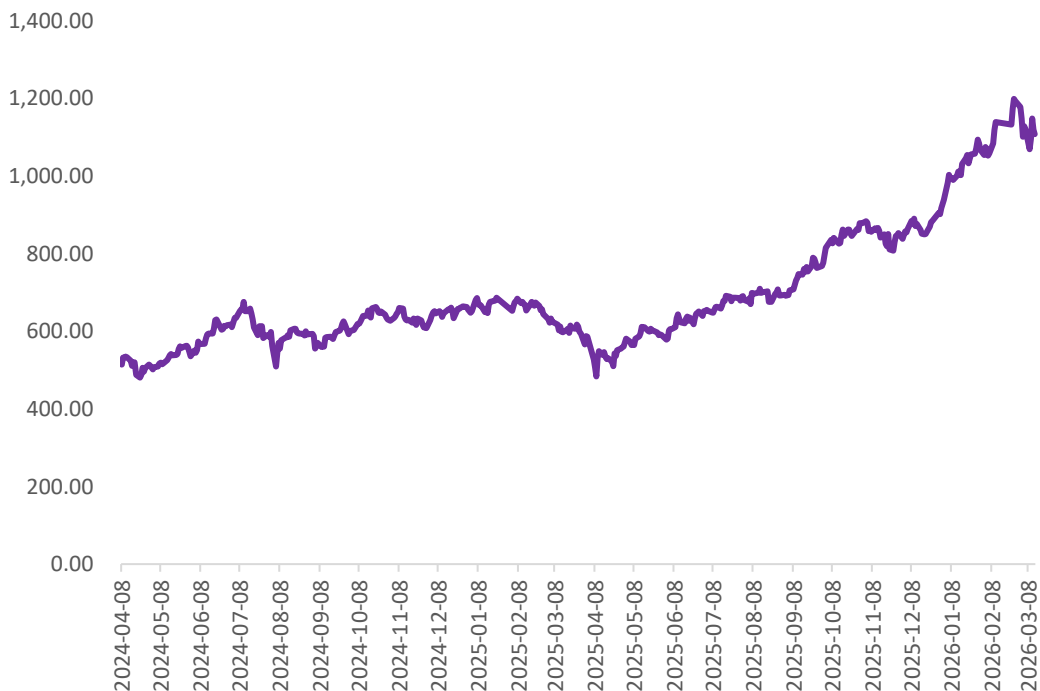


资料来源：wind，华鑫证券研究

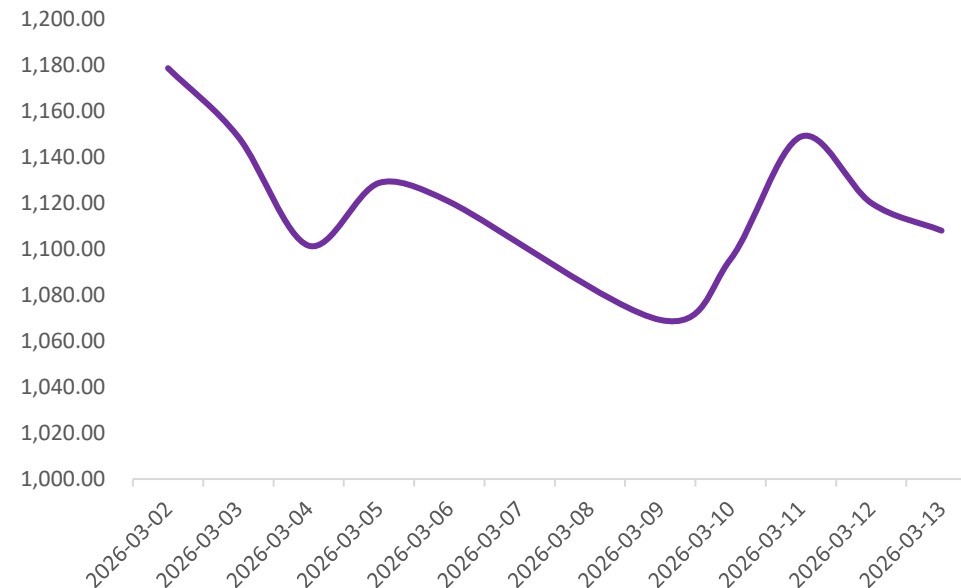
2.2、半导体：台湾半导体行业

此外，我们选取台湾半导体行业指数来观察行业整体景气。近两周来看，3月2月13日两周，台湾半导体行业指数呈现整体动荡的态势。近两年来看，2024年二季度台湾半导体指数呈现上涨的态势，随后进入震荡行情。2025年一季度台湾半导体指数进入下跌的行情，随后进入上行的态势。

图表9：台湾半导体行业指数近两年走势



图表10：台湾半导体行业指数近两周走势

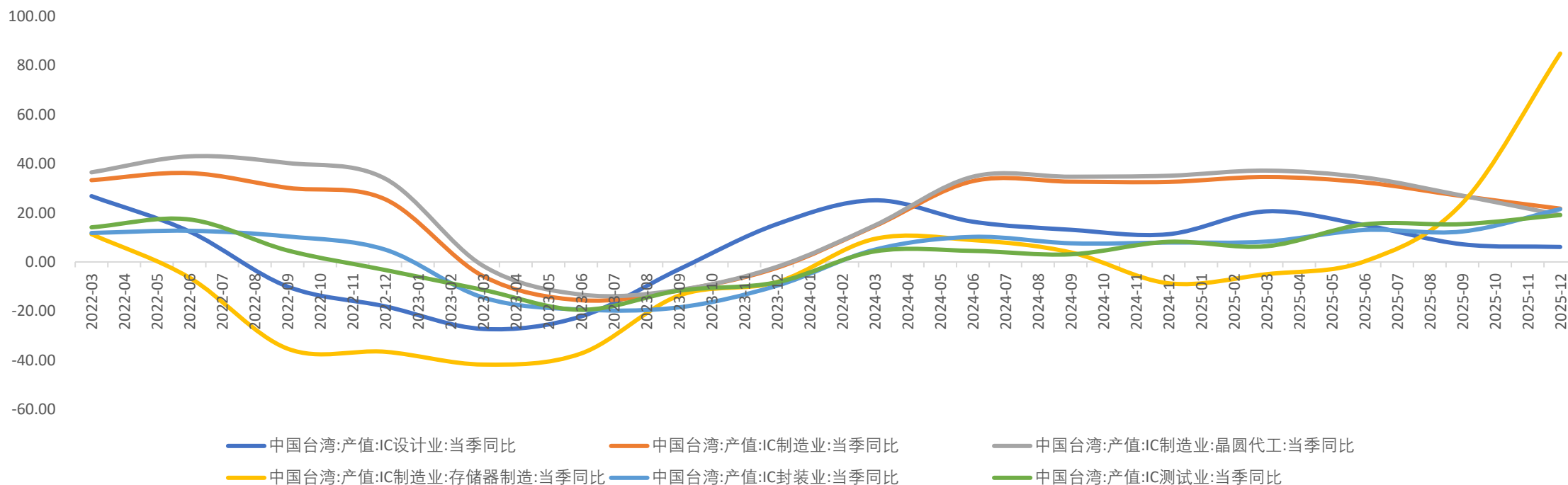


资料来源：wind，华鑫证券研究

2.3、半导体：中国台湾IC产值同比增速

我们可以通过中国台湾IC产值同比增速，将电子各板块合在一起观察：中国台湾IC各板块产值同比增速自2021年以来持续下降，从2023年Q2开始陆续有所反弹，各板块产值降幅均有所收窄。IC板块整体表现不佳，主要因为消费电子需求差，导致IC设计下滑，加之2021年缺货、涨价导致的2022年库存水位上升。但随着AI、5G、汽车智能化等应用领域的推动，2024年需求开始逐步回升。2025年，中国台湾IC设计、IC制造以及晶圆代工产值同比增速小幅下滑；中国台湾IC封装、测试业产值同比增速为维持平稳的增速；中国台湾存储器制造业进入下半年来，产值同比大幅提升。

图表11：中国台湾IC各板块产值当季同比变化（%）

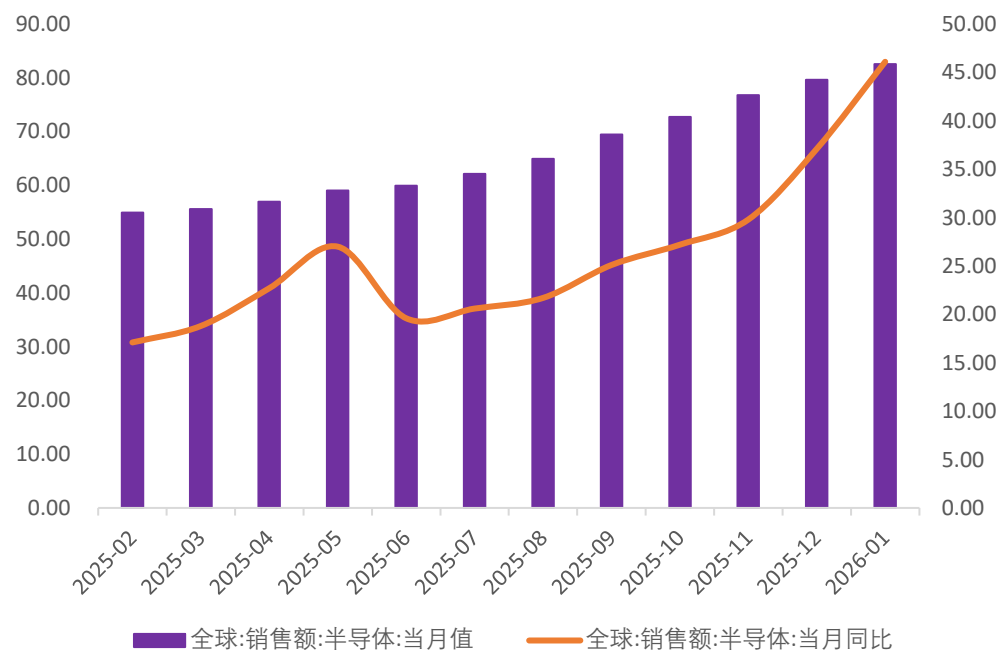


资料来源：wind，华鑫证券研究

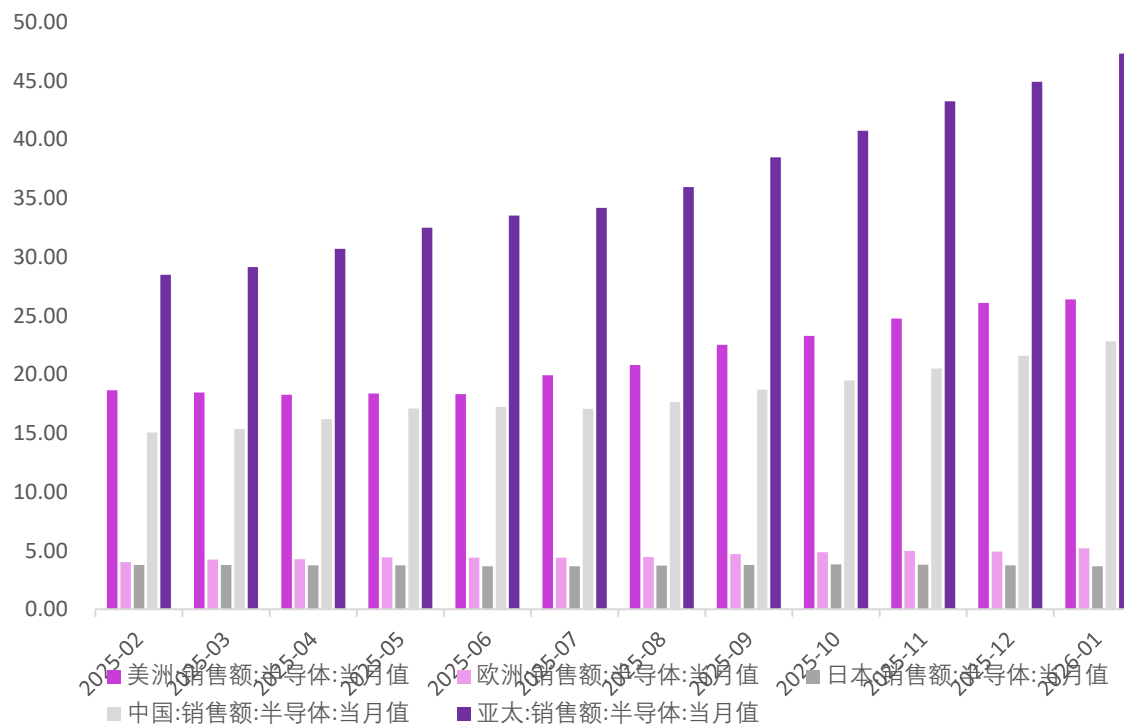
2.4、半导体：全球半导体销售额

全球半导体销售额自2024年年底出现小幅下降。2025年4月以来，全球半导体销售额呈现逐月攀升的态势，半导体行业景气度提升显著，2025年6月增速开始放缓，7-10月增速开始回升。2026年1月，全球半导体当月销售额为825.4亿美元，同比增长46.1%。其中，中国销售额为228.2亿美元，同比增长5.75%，占比达27.65%。

图表12：全球半导体销售额（单位：十亿美元）



图表13：全球半导体销售额按地区划分（单位：十亿美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

2.6、半导体：中国进口半导体设备数量

从中国进口半导体设备数量的维度来看，2023年以来，中国的半导体设备进口数量整体呈现平稳的态势。结合上文中国大陆半导体设备销售额攀升的趋势，我们认为国产设备正在逐步提升市场份额。

图表15：中国半导体设备及制造半导体器件或集成电路用装置进口数量（台）

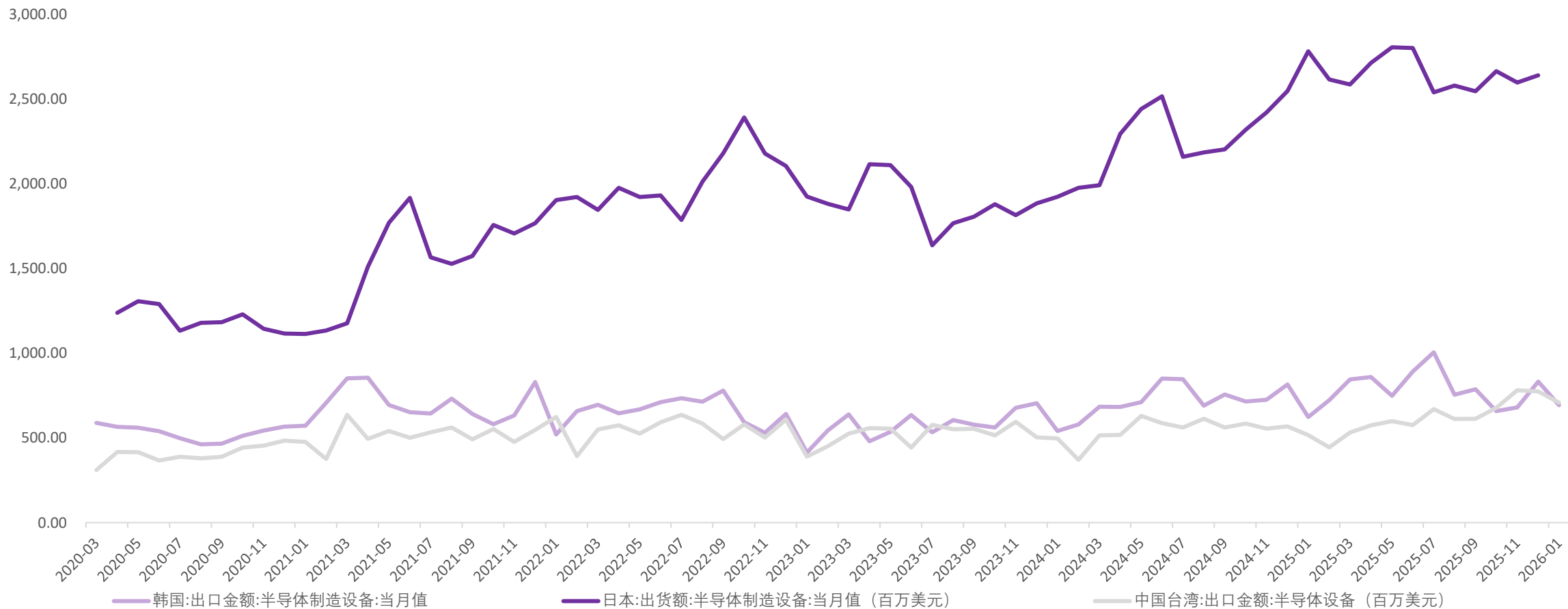


资料来源：wind，华鑫证券研究

2.7、半导体：海外市场半导体设备出口额

从海外市场半导体设备出口额的维度来看，2019年以来，韩国和中国台湾的半导体设备出口金额整体维持平稳的态势，日本半导体设备出口额整体呈现上升趋势。

图表16：海外市场半导体设备出口金额（百万美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

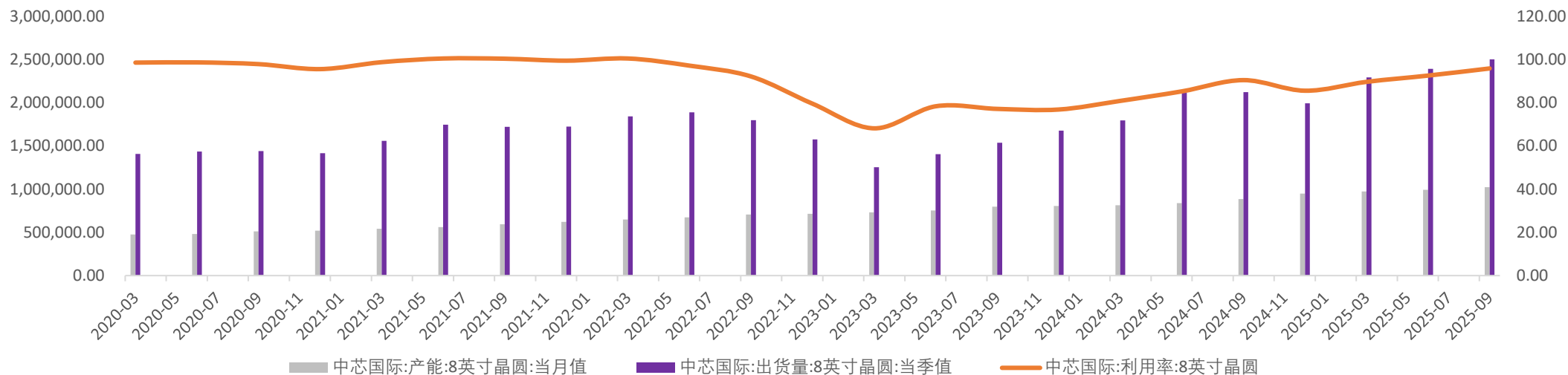
2.8、半导体：晶圆制造

晶圆制造方面，2018年至2025年9月，国产晶圆代工厂商中芯国际8英寸晶圆月产能从约45万片稳步提升至约102.3万片，实现翻倍以上增长，并历经稳步爬升、加速扩张及快速扩产三个阶段，尤其在行业调整期间中芯仍坚持逆周期布局，为后续复苏储备了充足产能。

产能利用率清晰地映射行业周期，从2020-2022年高景气期多次超过100%，到2023年下行期下滑至68.1%，随后自2023年第三季度起强劲反弹，至2025年第三季度已恢复至95.8%的高位，接近满产状态。在产能大幅扩张与利用率快速回升的共同推动下，季度出货量规模显著跃升，2025年第三季度达到近250万片，创历史新高，即便利用率未及上轮峰值，实际产出总量已远超以往。

整体来看，国产晶圆代工厂通过逆周期扩产把握了复苏机遇，出货规模的突破体现规模效应增强，也印证了汽车电子、工业控制、物联网等领域对成熟制程芯片需求的持续性与增长潜力。

图表17：国产晶圆代工厂产能、出货量、产能利用率数据（单位：片）

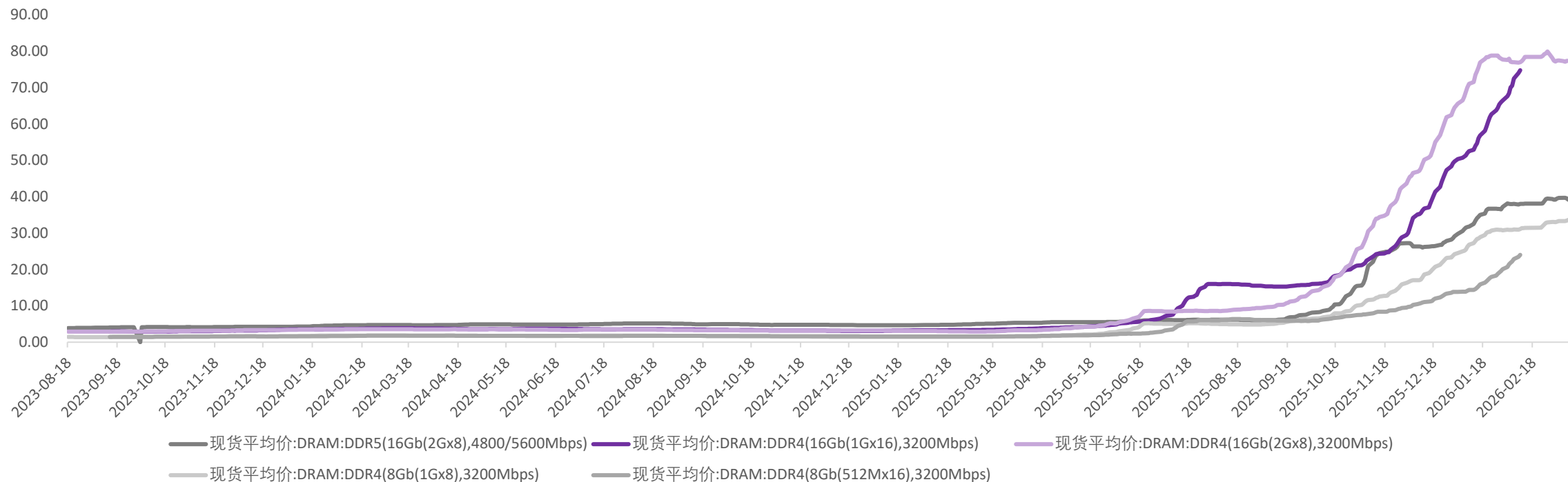


资料来源：wind，华鑫证券研究

2.9、半导体：存储芯片

存储芯片方面，由于AI存力需求提升以及海外大厂产能切换HBM等缘故，导致传统DRAM以及NAND类存储芯片价格大幅攀升。NAND方面：Wafer:512GbTLC现货均价从2024年3月底进入小幅回升，10月出现小幅下跌后变化趋于平缓，2025年3月以来小幅上涨，4月后价格略有下滑，7月后价格进入加速上涨阶段。2026年3月2日价格为20.59美元。DRAM方面：DRAM:DDR5(16Gb(8Gx2),4800Mbps)现货均价从2024年3月以来价格小幅上涨，9月之后呈现小幅下跌态势，9月之后又重回下跌态势，2025年1月以来呈现大幅上涨的态势，12月初出现小幅下跌，之后开始进入加速上涨阶段。2026年3月13日价格为39.33 美元。

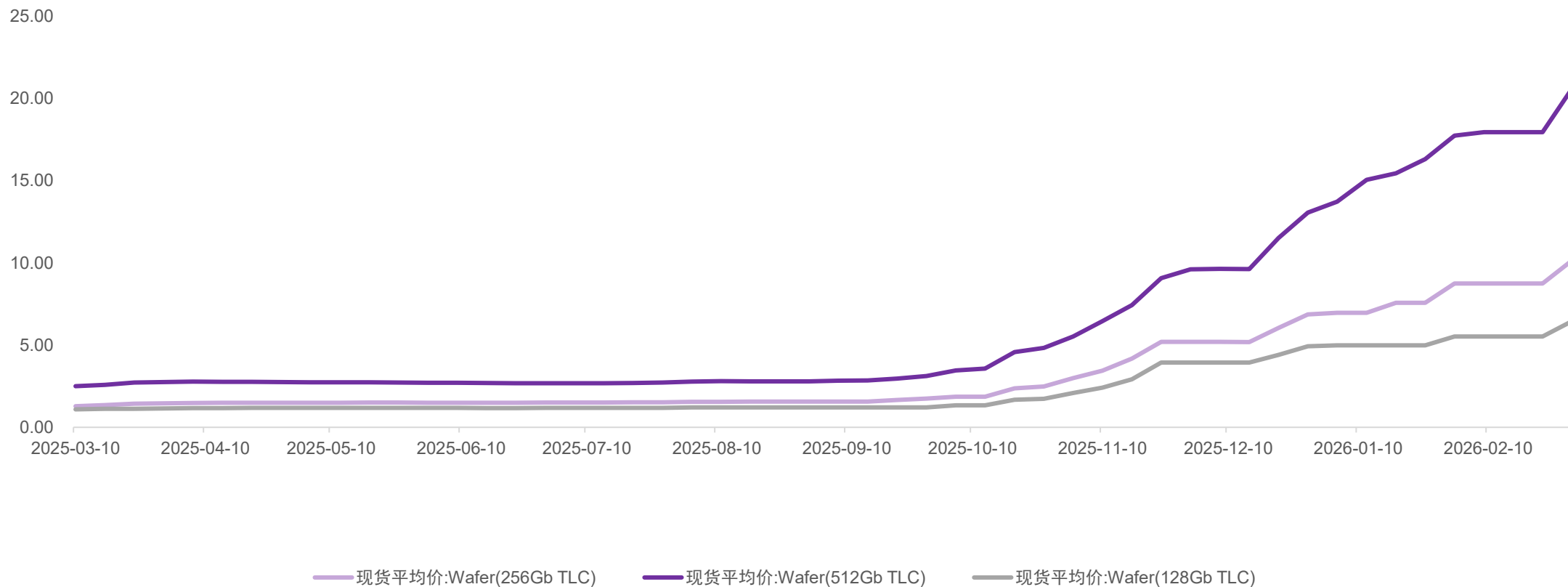
图表18：DRAM价格（单位：美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

2.9、半导体：存储芯片

图表19：NAND价格（单位：美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

03 行业动态

研究创造价值

■ 英伟达拟重启RTX 3060 GPU生产，可对华出口：采用三星8nm工艺

据报道，英伟达正准备通过三星电子的代工业务恢复其GeForce RTX 3060图形处理器（GPU）的生产。

三星电子代工部门预计将使用其8nm工艺重启RTX 3060的生产，该工艺与2021年该GPU首次亮相时所用的工艺相同。此举标志着这款中端芯片在停产约两年后重返三星。此前，英伟达已将新款RTX 40系列的主要生产转移到台积电。英伟达近期加大了旧款GPU的销售力度，并将RTX 3060的生产重新分配给三星，三星曾是这款Ampere架构芯片的原始代工厂。

英伟达决定重启RTX 3060显卡，很大程度上受到了美国针对销往中国的高性能AI芯片的出口管制政策影响。自2022年起，美国政府禁止出口英伟达的旗舰级AI GPU，包括基于Hopper和Blackwell架构的GPU。尽管英伟达推出了符合规定的替代产品，例如H20，但随后监管政策的调整，要求特定出口许可证，进一步削弱了该公司服务中国市场的能力。

据报道，英伟达重启RTX 3060显卡，旨在维持其在中国的商业地位。虽然这款芯片最初是为游戏而设计的，但它仍然能够处理某些入门级AI开发工作负载，使其成为那些无法购买高端加速器的客户的理想选择。

印度芯片制造提速：日产能将达8000万颗

3月13日消息，据印度媒体India Times报道，近日印度电子与半导体协会（India Electronics and Semiconductor Association, IESA）及SEMI 印度会长Ashok Chandak接受ANI采访时表示，随着印度本土新的半导体设施的启用，印度的芯片产能有望在今年底或明年初达到每日7,500 万至8,000 万颗的水平。

Ashok Chandak指出，这些产能将来自多个半导体计划，这些计划将分阶段开始生产。一旦这些工厂投入运营，印度的芯片封装和测试能力将显著扩展。虽然部分生产将满足印度国内需求，但预计将有相当一部分产品用于出口。他强调，随着这些设施的启用，印度在全球半导体价值链中的地位将发生变化。

目前，印度的短期活动主要集中在芯片的封装和测试，而非晶圆制造。例如，最近启用的美光科技（Micron Technology）设施做为ATMP（组装、测试、标记与封装）工厂运行，还被描述为智慧封装单元。其他正在开发的计划，包括塔塔电子（Tata Electronics）、凯恩斯科技（Kaynes Technology）和CG 电力及工业解决方案（CG Power and Industrial Solutions），将做为OSAT（外包半导体封装与测试）设施，执行类似的封装和测试工作。

晶晨股份：今年6nm芯片出货量有望突破3000万颗

近日，晶晨股份在接受机构调研时表示，公司6nm芯片2025年已完成近900万颗商用出货，技术成熟度、产品稳定性均已通过国际化客户和市场充分验证。目前该类产品的客户及市场覆盖广泛，包括ToB端的全球运营商市场，以及ToC端的全球知名消费电子客户。同时公司已将6nm制程延伸至更高算力的通用端侧平台，新产品将于2026年推出，产品矩阵更加完善，2026年公司6nm芯片出货量有望突破3000万颗，规模化放量将进一步带动公司业绩增长。

Wi-Fi 6芯片方面，2025年销量超700万颗，占比快速提升，已成为无线连接核心产品。后续公司将进一步推出Wi-Fi路由芯片、Wi-Fi 6高速低功耗芯片，2026年Wi-Fi 6芯片出货量有望破1000万颗，将进一步提升公司的市场竞争力。

面对全球存储市场的剧烈变化,公司凭借多元化渠道布局与丰富的产品品类，结合自身业务需求与市场预判，对存储芯片实施了前瞻性、合理有序的备货安排，有效保障了客户对公司SoC产品的需求，抵消了来自需求端的不利影响,维护了客户的供应链稳定。截止2025年第四季度，公司SoC主力产品营收已恢复到正常水平，2025年第四季度,公司营收同比增长约34%。

德州仪器4月1日起再涨价，最高达85%

据报道，电子元件供应链人士透露，德州仪器（TI）从4月1日起提高部分半导体产品的价格。

新价格已在公司内部定价系统中设定。预计此次价格调整将同时适用于直接客户和通过分销渠道采购的企业。

此次价格调整可能会影响德州仪器的部分模拟和嵌入式产品线。一些分销商表示，价格上涨幅度可能在15%到85%之间，覆盖数字隔离器、电源管理IC等核心产品，具体取决于器件和产品系列。德州仪器的销售团队已开始为部分分销商客户准备通知。包含更新后价格信息的电子邮件可能会在3月初发出。

业内人士指出，人工智能服务器、电动汽车和工业设备的需求持续支撑着模拟和电源管理芯片的市场。像德州仪器这样的大型供应商的任何价格变动都可能影响分销和现货市场的短期价格。

此前德州仪器已对工业控制、汽车电子等领域调价10%-30%。

算力增长25倍，Meta连发四款AI芯片：每6个月升级一代

当地时间3月11日，Meta公司宣布，继此前推出的两代AI芯片MTIA（Meta Training and Inference Accelerators）系列（MTIA 100、MTIA 200）成功商用后，现在正在开发四款全新的AI芯片，主要用于提升其生成式AI功能及内容排名系统。据介绍，这四款AI芯片分别为MTIA 300、MTIA 400、MTIA 450和MTIA 500，由Meta与博通公司合作开发，基于开源的RISC-V构架（采用的是Meta去年收购的Rivos公司的内核设计），并由全球领先的晶圆代工厂台积电（TSMC）生产。目前，MTIA 300已经开始生产，而其他三款芯片预计将在2027年初至年底之间出货。

在ISCA'23和ISCA'25上，Meta就曾发表了研究论文，详细介绍了前两代MTIA芯片：MTIA 100和MTIA 200（以前称为MTIA 1和MTIA 2i）。目前，Meta已经在业务中部署了数十万个MTIA系列芯片，加入了许多内部生产模型，并使用Llama等大型语言模型（LLM）测试了MTIA。

在MTIA 100和200推出之后，Meta正在连续开发四代MTIA系列芯片，包括MTIA 300、MTIA 400、MTIA 450和MTIA 500。这些新芯片计划在2026年或2027年部署，将覆盖从排名和推荐（R&R）推理扩展到R&R培训、通用GenAI工作负载和具有针对性优化的GenAI推理。

SK海力士完成LPDDR6验证，下半年启动量产供货

3月10日，韩国存储芯片大厂SK海力士宣布，已成功开发出最新的基于第六代10nm级（1c）工艺技术的16Gb LPDDR6 DRAM。SK海力士于今年1月在CES上展示了该产品，最近完成了全球首个1c LPDDR6开发验证。SK海力士计划在今年上半年完成量产准备工作，并在下半年开始供应产品，从而扩展其针对人工智能应用优化的传统DRAM产品线。1c LPDDR6主要用于配备设备端AI的智能手机和平板电脑等移动产品。

为了优化设备端AI部署，与现有LPDDR5X产品相比，LPDDR6产品的数据处理速度和能效均得到提升。得益于带宽的扩展和单位时间数据传输量的提高，本产品的数据处理速度较上一代提升了33%。其基础运行速度超过10.7 Gbps（10.7吉比特/秒），超越了现有产品的最高速度。通过应用子通道结构和DVFS（动态电压和频率调节）技术，与上一代产品相比，功耗降低了20%以上。

据介绍，子通道结构仅选择性地运行必要的數據路径，而DVFS技术的关键特性在于其能够根据移动环境调整频率和电压。在诸如高规格游戏等高要求环境下，设备会提升DVFS级别以获得最大带宽性能，而在日常使用中则会降低频率和电压以减少功耗。SK海力士希望通过这些技术进步，让消费者享受到更长的电池续航时间和更优化的多任务处理性能，并计划根据市场需求，为全球移动用户的需求做好准备。

追觅三芯连发：涵盖2nm智驾/手机/机器人,还有太空算力中心

3月11日下午，追觅科技在“AWE 2026 芯片产业高峰论坛”上，追觅生态企业“芯际穿越”首次披露芯片业务规划，发布了涵盖手机处理器、自动驾驶芯片、泛机器人SOC。此外，还有个人超脑、太空算力中心等多个前沿领域的产品。

据追觅芯际穿越负责人傅海洋透露，追觅即将推出的专为 AI 计算设计的旗舰手机处理器——赤霄 01，搭载了自研 NPU 架构，AI 等效算力高达 200 TOPS，可支持复杂逻辑推理与多轮对话的瞬时响应；在图形性能方面，可支持智能超分辨率画质增强、动态分辨率重构、帧率倍增及自适应高清渲染等核心技术。

面向机器人领域，追觅将推出“天穹”系列芯片，首款芯片已经量产，号称是行业集成度最高的SoC，将广泛应用在追觅机器人产品上。目前，该芯片处于即将流片或样片测试阶段，标志着追觅在广义机器人战略上从消费终端向出行场景的延伸。

AI引爆存储超级周期，供不应求至2027年

受人工智能浪潮驱动，存储芯片行业正迎来一轮强劲的“超级周期”。美银与10余家存储厂商的最新交流显示，尽管中东局势动荡，但对存储供应链影响甚微，而2月全球销售数据异常亮眼，进一步印证了行业的高景气度。

美银在本周与10多家存储芯片制造商及供应链公司的沟通中发现，所有受访厂商均表示中东冲突目前对业务“几乎没有实质性干扰”。这主要得益于存储产业链高度集中于亚洲——全球95%以上的存储芯片在此生产，材料本地化程度高，且设备运输多依赖空运，无需经过霍尔木兹海峡，有效规避了地缘政治风险。

在供应链安然无恙的同时，需求端则呈现出惊人的爆发力。韩国产业通商资源部数据显示，2月韩国半导体出口额同比暴增160.8%，达251.6亿美元，再创单月历史新高。这一增长由传统存储芯片价格大幅上涨与高带宽内存等产品结构优化共同驱动。

美银在报告中明确指出：“这显然是一个超级周期。”目前DRAM与NAND需求远超当前产能，供不应求的局面预计将持续至2027年上半年。在此背景DRAM行业平均营业利润率有望轻松超过60%，NAND则有望突破30%。厂商正积极谈判长期协议以锁定多年平均售价，彰显了对未来景气度的极高信心。随着AI应用持续渗透，存储芯片行业的高增长态势或将延续，市场格局持续向好。

04 公 司 公 告

研究创造价值

上海合晶:2025年年度报告

公司于2026年3月13日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《2025年度利润分配方案的议案》，2025年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2025年12月31日，公司总股本为665,458,353股，以此计算拟派发现金红利66,545,835.30元（含税），本次利润分配现金分红金额占2025年合并报表归属于母公司股东净利润的53.09%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配方案尚需经股东会审议批准。

芯朋微:2025年年度报告

公司2025年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。公司总股本131,310,346股，扣除回购专用证券账户中股份数2,258,565股，以此计算合计拟派发现金红利58,073,301.45元（含税），占公司2025年度合并报表归属上市公司股东净利润的31.17%。如在本董事会决议公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

寒武纪:2025年年度报告摘要

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润及转增股本，本次利润分配及资本公积金转增股本方案拟定如下：

(1) 向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税）。截至董事会决议日，公司总股本421,685,170股，扣除公司回购专用证券账户所持本公司股份36,600股后，实际可参与利润分配的股数为421,648,570股，以此计算合计拟派发现金红利632,472,855.00元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.71%。2025年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额20,061,625.99元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计652,534,480.99元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.69%。

(2) 向全体股东每10股转增4.9股。截至董事会决议，公司总股本421,685,170股，扣除公司回购专用证券账户所持本公司股份36,600股后，实际可参与公积金转增股本的股数为421,648,570股，本次转股后，公司的总股本为628,292,969股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

如在利润分配及资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用证券账户股份的基数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东会审议。

深圳市德明利技术股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）摘要

本激励计划拟授予激励对象的股票期权所涉及的标的股票总数为300.0000万股，占本激励计划草案公告日公司总股本22,684.5658万股的1.32%。其中，首次授予241.0000万份，占本激励计划草案公告日公司总股本22,684.5658万股的1.06%，占本激励计划拟授予股票期权总数的80.33%；预留59.0000万份，占本激励计划草案公告日公司总股本22,684.5658万股的0.26%，占本激励计划拟授予股票期权总数的19.67%（若首次授予股票期权在授予登记前，激励对象因离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会将激励对象放弃的权益份额直接调减，若调减后导致预留部分占调减后拟授予股票期权总数比例超过20%，则按预留部分占调减后拟授予股票期权总数20%的原则调减预留部分拟授予股票期权数量）。预留部分未超过本激励计划拟授予股票期权总数的20%。

在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，股票期权的数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。

05 风 险 提 示

研究创造价值

半导体出口管制及制裁加码风险

晶圆厂扩产进度不及预期风险

核心技术研发进展不及预期风险

地缘政治环境不稳定风险

重点覆盖公司业绩不及预期风险

吕卓阳：澳大利亚国立大学硕士，曾就职于方正证券，4年投研经验。2023年加入华鑫证券研究所，专注于半导体材料、半导体显示、碳化硅、汽车电子等领域研究。

何鹏程：悉尼大学金融硕士，中南大学软件工程学士，曾任职德邦证券研究所，2023年加入华鑫证券研究所。专注于半导体、PCB行业。

张璐：早稻田大学国际政治经济学学士，香港大学经济学硕士，2023年加入华鑫证券研究所，专注于光通信、存储等领域研究。

石俊烨：香港大学金融硕士，新南威尔士大学精算学与统计学双学位，研究方向为PCB方向。

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

免责条款

华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。本报告由华鑫证券制作，仅供华鑫证券的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告中的信息均来源于公开资料，华鑫证券研究部门及相关研究人员力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。我们已力求报告内容客观、公正，但报告中的信息与所表达的观点不构成所述证券买卖的出价或询价的依据，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并同时结合各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就财务、法律、商业、税收等方面咨询专业顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华鑫证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露。

本报告中的资料、意见、预测均只反映报告初次发布时的判断，可能会随时调整。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，华鑫证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。华鑫证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告版权仅为华鑫证券所有，未经华鑫证券书面授权，任何机构和个人不得以任何形式刊载、翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若华鑫证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，华鑫证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成华鑫证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。如未经华鑫证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。华鑫证券将保留随时追究其法律责任的权利。请投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的华鑫证券研究报告。

证券投资评级说明

股票投资评级说明：

	投资建议	预测个股相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	买入	>20%
2	增持	10%—20%
3	中性	-10%—10%
4	卖出	<-10%

行业投资评级说明：

	投资建议	行业指数相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	推荐	>10%
2	中性	-10%—10%
3	回避	<-10%

以报告日后的12个月内，预测个股或行业指数相对于相关证券市场主要指数的涨跌幅为标准。

相关证券市场代表性指数说明：A股市场以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以道琼斯指数为基准。



华鑫证券

CHINA FORTUNE SECURITIES

研 究 创 造 价 值